

公告

独立行政法人国際協力機構契約事務取扱細則（平成15年細則(調)第8号）（以下「細則」という。）に基づき下記のとおり公告します。

2024年3月13日

独立行政法人国際協力機構
契約担当役 理事

調達管理番号	23a00977
業務名称	インド国日印半導体サプライチェーン情報収集・確認調査【有償勘定技術支援】（一般競争入札（総合評価落札方式一ランプサム型））
目的	本調査は人材育成・連携、産学連携・共同研究促進、製造装置・部材を含む対インド投資促進、高度な基礎インフラ整備等の分野に焦点を当て、主に新規円借款事業を想定した新規支援方針案についての検討、及び既往円借款事業への半導体関連コンポーネントの組み込み、その他海外投融資等を含めた新たな協力の可能性の検討を進めるため、その前提となる情報収集・分析を実施するものである。なお、日印間半導体サプライチェーン協力の取り組みは、関係国間の重要技術分野の連携に貢献し、特定国へのサプライチェーン依存の低減、ひいては我が国の経済安全保障にも貢献することから、我が国の「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」構想やQUAD等の外交的取組にも資する。
業務種別	コンサルタント等契約-業務実施契約-【調査業務】基礎情報収集・確認調査
仕様等	入札説明書による
履行期間	2024年5月29日 ～ 2025年3月7日
選定方法	一般競争入札(総合評価落札方式)
業務量（人月）想定	7.00人月
競争参加資格	公告・公示日において有効である全省庁統一資格を有すること。 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。 契約事務取扱細則第4条に該当しないこと。 その他、入札説明書に記載の参加要件に該当すること。
入札説明書配布依頼受付 期限及び方法	2024年3月19日 12時00分 まで https://www2.jica.go.jp/ja/announce/index.php?contract=1
技術提案書提出期日	2024年3月29日 12時00分
入札・開札日時	2024年4月11日 10時00分
その他	その他詳細は入札説明書による

以上